

国家集成电路创新中心 上海市真空学会 上海市集成电路行业协会

2023 中国真空技术与半导体应用大会 ---暨半导体真空设备与零部件高端论坛 第一轮会议通知

半导体产业的蓬勃发展，为半导体制造工艺和器件的技术研究，产学研用的协同创新，真空技术的应用提供了无限机遇和广阔发展空间。为促进半导体及真空技术科研院所、真空设备及零部件企业、半导体制造企业（集成电路、新能源、LED、汽车电子等）之间的深度交流和融合创新，探寻针对性、实效性合作机会，定于 2023 年 8 月 20-22 日在上海举办“2023 中国真空技术与半导体应用大会暨半导体真空设备与零部件高端论坛”。现将有关事项通知如下：

一、会议主题

- 1、集成电路、新能源、LED、汽车电子领域中先进半导体工艺、器件
- 2、ALD/PVD/CVD 及外延技术在半导体研究和产业中的应用
- 3、真空技术在先进半导体工艺、器件领域中的应用
- 4、真空设备及其零部件在半导体领域中的应用
- 5、企业与科研院所产学研合作对接

二、参会人员

- 1、从事半导体工艺、器件及设备等领域（集成电路、新能源、LED、汽车电子）研究的科研院所课题组长、系主任、副院长、院长和学生。
- 2、利用真空、等离子体等技术进行半导体器件功能薄膜制备（ALD/PVD/CVD/外延等）研究的科研机构，包括大学、研究所的教师和学生。
- 3、半导体应用领域真空镀膜设备、真空测量、真空零部件等企业的管理者和技术负责人。
- 4、集成电路、新能源、LED、汽车电子等领域的制造企业管理者和技术负责人。

三、参会价值

- 1、**科研院所人员**：直面行业顶级学者、专家，获得行业技术前沿热点及发展趋势，获得国家级、省部级项目的新动向、新机遇；直面企业技术高管和决策者，获得产学研潜在合作机会。
- 2、**企业人员**：直面企业内技术高管和采购决策者，获得进入科研院所和半导体产业市场的机会和人脉；直面行业技术负责人、学者、专家，获得企业技术难题解决方案、前沿技术路线和 market 发展趋势；有助于企业把握战略商机、提升行业认知度。

四、组织单位

指导单位：工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国半导体行业协会、上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术协会

主办单位：国家集成电路创新中心、上海市真空学会、上海市集成电路行业协会

承办单位：复旦大学微电子学院、上海复创芯半导体科技有限公司、上海浦东人才发展有限公司、科创板日报

协办单位：浙江省真空学会、江苏省真空学会、安徽省真空学会、

中国传感器与物联网产业联盟、复旦大学国家大学科技园、浦东国际人才驿站

支持媒体：中国真空网、上海真空学会网、真空技术与设备网、半导体行业联盟、大同学吧

五、会议时间、议程与地点

- 1、会议时间：2023年8月20-22日
- 2、会议议程：
8月20日 大会报到
8月21日 上午：大会报告-1 下午：分会报告、墙报 晚上：晚宴
8月22日 上午：分会报告、墙报 下午：大会报告-2、颁奖
(备注：会议议程持续更新，以现场实际安排为准)
- 3、会议地点：上海市张江科学会堂（中国上海市浦东新区海科路1393号）
(地铁13号线学林路站1号口，步行420米)

六、论文摘要/企业需求征集

- 1、会议论文摘要（详见附件1“会议论文摘要模板”）
- 2、企业技术难题攻关、产学研对接需求（相关资料请发送至邮箱 kjzy@fudan.edu.cn）

七、会议参展及赞助

本次会议及论坛的参展和赞助，详见附件2“会议赞助权益清单”。

八、注册费用及报名

名称	费用（元/人）	
	7月30日前缴费	7月30日后及现场缴费
会议代表	2300	2800
学生代表	1500	1800



请参会人员于2023年7月30日前以电子邮件（详见附件3“会议参会回执表”）或微信扫码（右上二维码）填写参会登记。

九、注册费缴纳与发票

1、注册费缴纳采用转账汇款或者现场缴费的方式进行，不收现金。现场缴费可通过刷卡、微信、支付宝支付，并开具电子增值税普通发票。

2、转账汇款信息如下：

账户名：上海复创芯半导体科技有限公司

账号：310066344013005923958

开户行：交通银行股份有限公司上海同济支行

(备注：汇款时请备注“姓名+单位”信息)

十、报名及赞助联系方式

- 1、会议 Email: kjzy@fudan.edu.cn
- 2、院校师生报名及论文投递联系人，刘老师，电话：13918283051
- 3、企业报名及酒店住宿联系人，王老师，电话：13817092767



2023 中国真空技术与半导体应用大会 ---暨半导体真空设备与零部件高端论坛 附件 1-会议论文摘要模板

原子层沉积钨基铁电薄膜及其可靠性研究

李**¹ 黄**¹ 顾**¹ 张**^{1,2} 卢**^{1,2*}

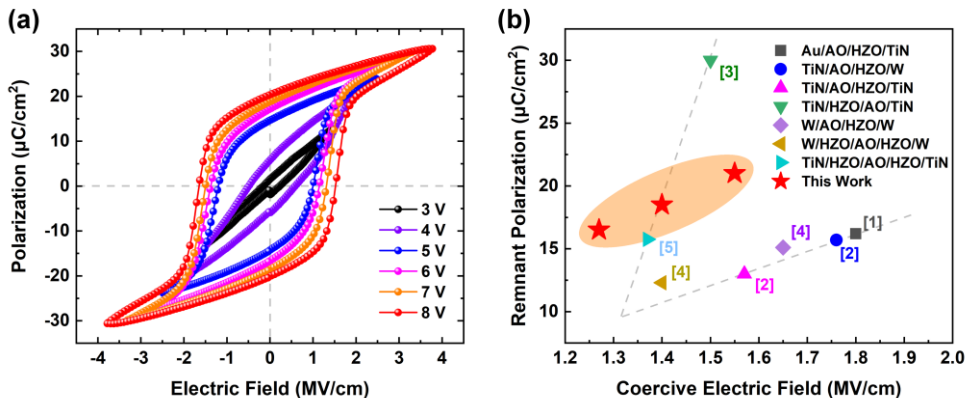
¹复旦大学 微电子学院 专用集成电路与系统国家重点实验室 上海 邮编 200433

²国家集成电路创新中心, 上海, 邮编 201203

*Email: ***-example@fudan.edu.cn

摘要: 论文摘要版面内容不超过 A4 纸一页, 1.0 倍行间距。字体: 标题为三号黑体, 作者名小四号楷体, 单位为五号楷体, 摘要正文为五号宋体。报告人加下划线, 通信作者加星号, 并在单位后另起一行注明通信作者的电子邮箱地址 (五号楷体)。报告人与通信作者可以是同一个人, 也可以不同。请注意保留页边距, 上下 2.54 厘米, 左右 3.17 厘米。给出摘要关键词 3~5 个。摘要应反映文章的主要信息, 包括目的、方法、结果和结论四要素。建议插入图表, 并给出相关的重要参考文献 [1,2]。文末可附加不超过 150 字的第一作者简介 (1.15 倍行间距)。摘要也可以用英文撰写。

关键词: 原子层沉积, 掺杂的 HfO₂ 薄膜, 界面, 极化强度, 可靠性



参考文献:

- [1] Z. C. Dong, * X. L. Zhang, H. Y. Gao, Y. Luo, C. Zhang, L. G. Chen, R. Zhang, X. Tao, Y. Zhang, J. L. Yang, J. G. Hou, * "Generation of molecular hot electroluminescence by resonant nanocavity plasmons", *Nature Photonics* 4, 50-54 (2010).
- [2] R. Zhang, Y. Zhang, Z. C. Dong, * S. Jiang, C. Zhang, L. G. Chen, L. Zhang, Y. Liao, J. Aizpurua, Y. Luo, J. L. Yang, and J. G. Hou, * "Chemical mapping of a single molecule by plasmon enhanced Raman scattering", *Nature* 498, 82 (2013).

个人简介:

李**, 复旦大学在读博士研究生。。。。。

Title [Capitalize Only the First Letters of All Words Except for Coordinating Conjunctions, Articles, and Prepositions; Arial 14 Point Bold; Centered; Title Case]

Blank line [fixed 1.15 line spacing]

Author(s) [Presenting author and co-author affiliation, city, and country. Be sure to include the presenting author's e-mail; Arial; 10.5 point; centered]

Blank line [fixed 1.15 line spacing]

Abstract: Times New Roman, 10.5 point; Line Spacing, 1.0; Paragraphs should be indented; tables, schemes, and figures should be placed at appropriate positions by the author; the manuscript will be directly passed to the offset printer; write the manuscript on an A4 paper (margins; 2.54 cm for Up and down, 3.17 cm for Left and Right) just as in this template.

Keywords:

Figures or Tables

Refences:

- [1] Z. C. Dong, * X. L. Zhang, H. Y. Gao, Y. Luo, C. Zhang, L. G. Chen, R. Zhang, X. Tao, Y. Zhang, J. L. Yang, J. G. Hou, * "Generation of molecular hot electroluminescence by resonant nanocavity plasmons" , *Nature Photonics* 4, 50-54 (2010).
- [2] R. Zhang, Y. Zhang, Z. C. Dong, * S. Jiang, C. Zhang, L. G. Chen, L. Zhang, Y. Liao, J. Aizpurua, Y. Luo, J. L. Yang , and J. G. Hou, * "Chemical mapping of a single molecule by plasmon enhanced Raman scattering" , *Nature* 498, 82 (2013).

Biography:

Deadline: Jul. 30, 2023.

2023 中国真空技术与半导体应用大会 ---暨半导体真空设备与零部件高端论坛

附件 2-会议赞助权益清单

项目	权益内容	价格/元
钻石赞助	<ol style="list-style-type: none"> 1、主会场大屏幕显示“钻石赞助”名称； 2、会议休息期大屏幕播放赞助单位广告片（广告片由赞助单位提供，时长不超过 3 分钟）； 3、会议现场一个展台（展台尺寸：6m*2m，布展由企业自行负责）； 4、一个大会演讲报告； 5、会议论文集印刷“钻石赞助”名称； 6、会议论文集封一彩色插页； 7、参会证印刷公司 LOGO； 8、晚宴主桌就座（限 1 人）； 9、晚宴致辞； 10、活动现场展示易拉宝三个（企业提供易拉宝）； 11、晚宴会场展示易拉宝二个（企业提供易拉宝）； 12、奖项冠名； 13、颁奖嘉宾； 14、颁发赞助单位奖牌和证书； 15、三个会议参会名额。 	100000 元/家， 限定 1 家。
铂金赞助	<ol style="list-style-type: none"> 1、主会场大屏幕显示“铂金赞助”名称； 2、会议休息期大屏幕播放赞助单位广告片（广告片由赞助单位提供，时长不超过 2 分钟）； 3、会议现场一个展台（展台尺寸：4m*2m，布展由企业自行负责）； 4、一个分会演讲报告； 5、会议论文集印刷“铂金赞助”名称； 6、会议论文集中一页彩色插页； 7、参会证印刷公司 LOGO； 8、晚宴主桌就座（限 1 人）； 9、活动现场展示易拉宝二个（企业提供易拉宝）； 10、晚宴会场展示易拉宝一个（企业提供易拉宝）； 	50000 元/家， 限定 3 家。

	<p>11、颁奖嘉宾；</p> <p>12、颁发赞助单位奖牌和证书；</p> <p>13、两个会议参会名额。</p>	
金牌赞助	<p>1、会议现场一个展台（展台尺寸：3m*2m，布展由企业自行负责）；</p> <p>2、一个分会演讲报告；</p> <p>3、会议论文集印刷“金牌赞助”名称；</p> <p>4、会议论文集中一页彩色插页；</p> <p>5、活动现场展示易拉宝一个（企业提供易拉宝）；</p> <p>6、颁发赞助单位奖牌和证书；</p> <p>7、一个会议参会名额。</p>	30000 元/家， 限定 5-8 家。
银牌赞助	<p>1、会议现场一个展台（展台尺寸：2m*2m,企业提供展台背板内容）；</p> <p>2、活动现场展示易拉宝一个（企业提供易拉宝）；</p> <p>3、会议论文集中半页彩色插页；</p> <p>4、会议论文集印刷“银牌赞助”名称；</p> <p>5、颁发赞助单位奖牌和证书。</p>	20000 元/家， 限定 10-15 家。
铜牌赞助	<p>1、会议现场一个展台（展台尺寸：2m*2m,企业提供展台背板内容）；</p> <p>2、论文集印刷公司名称和 LOGO；</p> <p>3、颁发赞助单位奖牌和证书。</p>	10000/家， 不限。
资料入袋	<p>参会代表资料袋中放置赞助单位的宣传资料一本（纸张最大不超过 A4，页数不超过 10 页），资料由赞助方提供（资料内容需先经会议会务组审核）</p>	5000 元/家
纪念品赞助	<p>组委会审核</p>	具体详谈

*详情请咨询会议联系人，王老师，电话：13817092767。

2023 中国真空技术与半导体应用大会 ---暨半导体真空设备与零部件高端论坛

附件 3-会议参会回执表

填表时间：2023 年 月 日

单位名称						
通讯地址				邮 编		
经办姓名			职 务		电 话	
手 机			部 门		E-mail	
代表姓名	性别	部门	职务/职称	手机	E-mail	
论文摘要 题目					<input type="checkbox"/> 口头报告 <input type="checkbox"/> 墙报展示	
收款单位	收款单位：上海复创芯半导体科技有限公司 开 户 行：交通银行股份有限公司上海同济支行 帐 号：310066 344013 005923 958 开户银行行号：1023 6100 2264					

会议 Email: kjzy@fudan.edu.cn

院校师生报名及论文投递联系人，刘老师，电话：13918283051

企业报名、赞助及酒店住宿联系人，王老师，电话：13817092767